

Symposium on Engineering, Medicine, and Biology Applications

時間：April 28-30, 2017

地點：新竹豐邑喜來登大飯店



榮譽主席

吳重雨講座教授
(國立交通大學)

陳適卿副院長
(臺北醫學大學)

大會主席

何彥毅醫師
(台灣生醫電子工程協會理事長)

議程主席

鄭桂忠教授
(國立清華大學)

展示主席

關河鳴教授
(國立交通大學)

課程主席

陳新教授
(國立清華大學)
林伯剛醫師
(台北榮民總醫院)

論文競賽主席

林宗賢教授
(國立臺灣大學)

產學媒合主席

邱進峰副總經理
(晶神醫創股份有限公司)

大會諮議委員

李國賓講座教授
(國立清華大學)
柯明道教授
(國立交通大學)
呂學士教授
(國立臺灣大學)
邱俊誠教授
(國立交通大學)

大會主題

Circuits and Systems for Better Life and Environment

大會目的

生醫工程應用研討會 (SEMBA) 之主要目的為架構生物醫學與工程領域專家學者對話之平台，期望藉由跨領域的交流，激盪思考的火花與合作的契機，達到產、學、研整合研發及創意實現之目的。本研討會之終極目標為建構成為跨生醫與工程研究領域之旗艦級會議，兼具教育、產業、與研究推動之功能，並進而引領臺灣生醫工程產業之創新發展，謀求人類科技文明之福祉。

論文領域

1. Bioinspired Systems and Biosignal Processing
2. Biomedical Imaging
3. Biosensors and Lab-on-a-Chip
4. Circuits and Systems for Biomedical Applications
5. Biomedical Instrumentation
6. Sensor Networks and Telecare Systems
7. Clinical Application-Diagnostic, Monitoring, and Therapy
8. Chinese Medicine
9. Wearable Devices and Mobile Health
10. Mobile Cloud Computing, Internet of Things and Big Data
11. Medical Decision Support Systems
12. Drug Delivery
13. Unmet Medical Need
14. Nano Biomedicine
15. Stem Cell Biotechnology
16. Other Topics

論文格式

限以英文書寫，內容請用A4，Double-Column 10 點格式，1至2頁，標準範例可至大會網址：<http://semba2017.twemba.org.tw>下載

投稿方式

一律電子投稿，限用PDF檔案格式。投稿獲接受，均以原稿刊登。

重要日期

投稿截止日

2017/2/26

錄取通知日

2017/3/28

註冊截止日

2017/4/16



主辦單位：台灣生醫電子工程協會
指導單位：教育部產業創新提升人才培育計畫
智慧電子總聯盟
大會網址：<http://semba2017.twemba.org.tw>

連絡方式：
台灣生醫電子工程協會 何鈺美
E-mail: emba168@gmail.com
TEL: 03-5742312